

证券代码：688627

证券简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 现场调研</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：券商策略会</div>
参与单位	中银基金、汇添富、信达澳亚、华安基金、景顺长城、太平基金、南方基金、前海开源基金、上银基金、浦银安盛、嘉实基金、长信基金、富国基金、诺德基金、金信基金、永赢基金、鹏华基金、博时基金、银华基金、银河基金、大家资产、上海钦沐资产、上海烜鼎资产、易川资产、中银资产、华泰资产、前海海运通资产、深圳市尚诚资管、华美国际、昆仑健康险、光证资管、交银保险、中信保诚、友邦人寿、汇华理财、湖南源乘私募、上海明河、上海东方证券资产、青骊投资、上海呈瑞、海南鑫焱、全天候私募、前海辰星、杭州睿银、上海德汇、上海正心谷、广发证券、西部证券、长江证券、华安证券、中邮证券、财通证券、东方证券、国泰海通、华泰证券、中泰证券
时间	2025 年 8 月 30 日、2025 年 9 月 3 日
地点	进门财经线上平台、公司会议室
接待人员姓名	董事长：张滨 董事：谢思遥 董事、财务负责人：崔小兵 董事会秘书：彭娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司管理层介绍 2025 年半年度经营情况</p> <p>公司处于全球 AI 技术快速发展与地缘政治推动产业链重构的关键时期。作为半导体检测测试领域企业，公司发展与国家产业升级、科技自立自强战略紧密相连。</p> <p>在 AI 技术应用深化、先进封装及 HBM 需求增长的推动下，公司 2025 年第二季度实现营收 2.92 亿元，同比增长 4.65%；扣除非经常性损益及股份支付影响后的归母净利润接近 5000 万元。2025 年上半年，公司累计营业收入 4.44 亿元，同比增长 22.68%。其中半导体业务成为核心产品线，</p>

上半年营收占比超过 70%。公司同期整体毛利率明显改善，显示业务毛利率创阶段性新高。

业务合作方面，显示业务与半导体业务分别获得头部厂商大额订单。此前公司针对半导体团队实施的股权激励计划成效显著，后续将围绕 AI 驱动下高算力、高存储相关需求持续布局，目标构建覆盖半导体测试检测设备全站点的服务平台。

二、问答交流环节

1.公司的 CP 和高速 FT 设备，和海外友商相比如何？当前海外友商是否交期比较长？

答：公司 CP 和高速 FT 设备整体性能对标国际领先产品，产品规格及迭代规划贴合客户需求。公司依托自主研发及本地化生产，交付与响应更优，能更好满足客户需求。

2.公司年报提到在分选机、探针台等测试设备方面进行研发布局，这方面进展可以分享一下吗？每万片需要用到多少设备？

答：分选机、探针台是公司针对先进封装高端用途的战略布局，需与关键测试设备配合。具体依客户产品性能及设备匹配度而定。

3.公司 SoC 测试机的研发规划是什么？与 DRAM 设计有何研发协同？

答：公司 SoC 测试机研发聚焦高端算力芯片测试范围全覆盖，对标业界高端产品，目标客户为国内高端算力芯片客户，目前已开展联合研发探讨。公司 SoC 测试产品线与 DRAM 测试产品线在技术、市场及高端算力芯片业务机会上存在多方面协同，当前逐步将 DRAM 领域积累关键技术整合到 SoC 测试机中，提升对采用先进封装技术的高端算力芯片测试覆盖能力。

4.公司 HBM 相关设备（如 KGSD CP 测试机、老化测试机）的进展和验证情况如何？

答：KGSD CP 测试机样机已在客户现场进行验证测试，速率满足 HBM 测试要求。公司战略布局自主研发关键 ASIC 芯片，芯片技术与 CP、高速 FT 测试机共享积累。老化测试机在已稳定量产供应 DRAM 客户的基础上，进一步推动技术升级和客户拓展，未来将在先进封装、复杂技术领域广泛应用。公司关键设备将布局下一代产品需求。

5.公司测试机与国内友商相比有哪些竞争优势？未来市场份额如何展望？

	<p>答：公司竞争优势主要体现在：一是产品全自研，自主可控和迭代能力强；二是产品线覆盖全面，从研发、关键设备到测试配件及系统级测试均有布局；三是产品以开放通用态势研发和拓展，市场空间较大。公司作为自主研发关键核心部件、核心芯片并提供端到端全栈技术和产品的设备供应商，具备较强壁垒和护城河。</p> <p>6.公司老化测试机和探针卡在新签订单中的市占率如何？</p> <p>答：新签订单中公司市占份额逐步提升。探针卡方面，公司是国内 MEMS 工艺探针卡领域领先供应商；老化测试机技术升级提升毛利，满足客户降成本需求，未来几年需求旺盛。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 8 月 30 日、2025 年 9 月 3 日